

Xe-PFIBを用いた広域断面のSEM観察

数十nmオーダーの狙い精度で数百 μm 角の断面観察

測定法 : SEM・X線CT・FIB加工

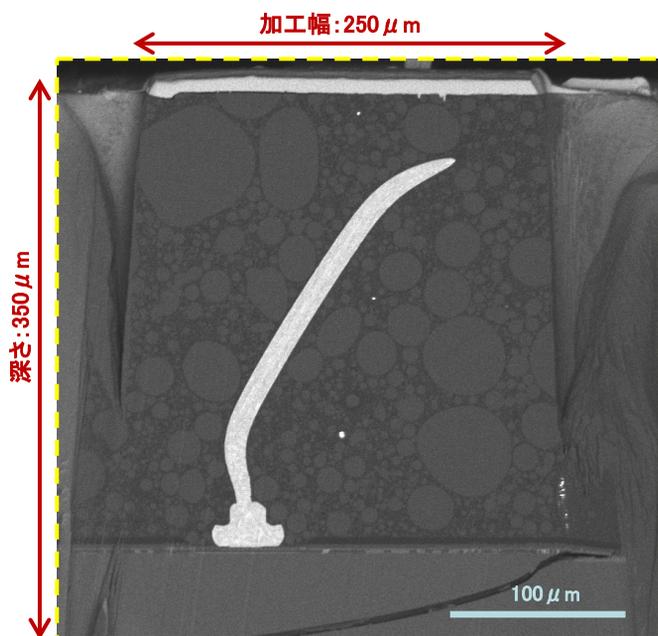
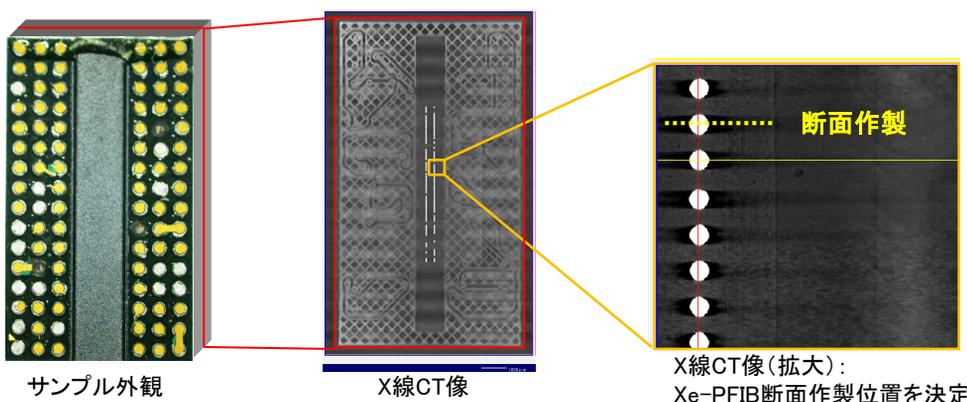
製品分野 : LSI・メモリ

分析目的 : 形状評価、構造評価、製品調査

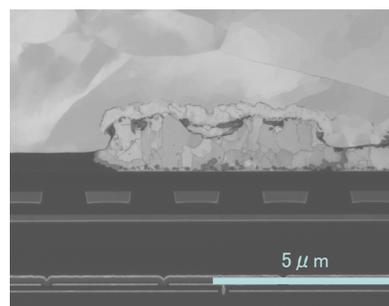
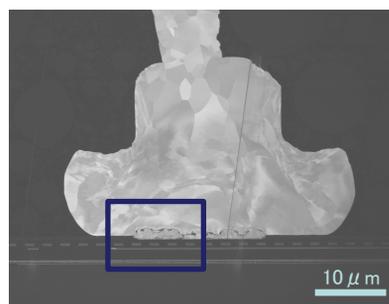
概要

集積回路、電極やプリント基板、半導体パッケージの電極を電氣的に接続する金属製ボンディングは直径数十 μm ～数百 μm 程です。Xe-PFIB(Xe-Plasma Focused Ion Beam)では数十nmオーダーで加工位置を狙い、数百 μm 角の断面を作製できるため、ボンディング中央にて全景を詳細に把握することができます。

データ



Xe-PFIB断面のSEM像



Xe-PFIB断面のSEM像(拡大)



✓ 数十nmの精度で数百 μm 角の断面加工が可能です

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

一般財団法人
MST 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp
URL : <https://www.mst.or.jp/>